

Chemicals contained in products

Package-type

Epson Package name; **SSOP3-24PIN**

JEITA Package name; **P-LSSOP24-05.60x07.80-0.65**

Lead frame plating; **Lead(Pb) Free**

Weight; **0.13 [g] ※1**

Part	Subpart	Subpart weight [mg]	Substance name	CAS No.	Content *Note2		Application
					[mg]	[ppm]	
チップ	ICチップ	10	シリコン	7440-21-3	9.6	999894	主成分
			ホウ素	7440-42-8	0.00002	2	ドーパント
			無機リン	7723-14-0	0.00005	5	ドーパント
			アルミニウム	7429-90-5	0.0002	20	配線材
			ヒ素 ※3	7440-38-2	0.00005	5	ドーパント
			フッ素 ※3	7782-41-4	0.00002	2	ドーパント
			チタン ※3	7440-32-6	0.0002	20	配線材
			モリブデン ※3	7439-98-7	0.0002	20	配線材
			タングステン ※3	7440-33-7	0.0003	30	配線材
			コバルト ※3	7440-48-4	0.00002	2	配線材
パッケージ	保護膜	0.19	ポリイミド	-	0.19	1000000	保護膜 ※4
			ダイアタッチ材				
	ダイアタッチ材	0.50	銀	7440-22-4	0.41	817073	主成分
			エポキシ樹脂	-	0.061	121951	接着剤
			フェノール樹脂	-	0.030	60976	接着剤
	端子メッキ	1.3	錫	7440-31-5	1.3	975000	鉛フリーはんだ
			銀	7440-22-4	0.033	25000	鉛フリーはんだ
			銅	7440-50-8	43.5	945000	導体材
	リードフレーム	46	銀	7440-22-4	0.23	5000	インナーリードメッキ
			その他 ※5	-	2.3	50000	添加剤
			金	7440-57-5	0.28	1000000	導体材
	ボンディングワイヤー モールド樹脂	0.28 72	エポキシ樹脂	-	5.8	80000	主成分
			三酸化アンチモン	1309-64-4	1.1	15000	樹脂難燃剤
			ブロム化エポキシ樹脂	-	0.72	10000	樹脂難燃剤
			シリカ	60676-86-0/-	59.0	819000	充填材
			カーボンブラック	1333-86-4	0.22	3000	樹脂着色剤
			硬化剤(フェノール樹脂等)	-	5.0	70000	硬化剤
			有機リン化合物	-	0.22	3000	硬化促進剤

化学物質の情報について

- ※1 パッケージの重量は、内蔵するチップのサイズ等、個別のIC仕様により多少異なる場合があります。
- ※2 含有データは、製品への意図的添加及び各サプライヤーからの情報に基づき算出された値であり、保証値ではありません。
- ※3 従って、実測値はこのデータと多少異なる場合があります。
- ※4 これらの物質は、内蔵するICチップの仕様により、含有する場合としない場合があります。
- ※5 個別の機種により保護膜を使用しない場合があります。
- ※6 Cuタイプの場合は、ニッケル、亜鉛、錫、ケイ素、鉄、酸化亜鉛が、42alloyタイプの場合は、炭素、ケイ素、マンガンが含まれます。